

## 目 录

一、最近三年非经常性损益的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、最近三年非经常性损益明细表·····	第 3—4 页
三、最近三年非经常性损益明细表附注 ·····	第 5—12 页

# 关于杭州士兰微电子股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告

天健审〔2023〕1283号

杭州士兰微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）管理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2020—2022年度）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供士兰微公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为士兰微公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

士兰微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对士兰微公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，士兰微公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，如实反映了士兰微公司最近三年非经常性损益情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年三月二十九日

### 最近三年非经常性损益明细表

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,122,546.18	-5,605,928.91	-1,076,979.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	77,851,609.31	62,614,254.22	116,936,036.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	460,202.12	68,672.85	114,799.12
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	426,383,780.71	686,107,163.58	4,062,459.89

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,491,083.84	1,739,378.52	1,777,112.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,369,132.67	-1,306,883.83	788,598.90
小 计	504,433,262.47	743,616,656.43	122,602,026.84
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	76,615,294.15	108,387,662.79	18,371,525.36
少数股东损益	6,658,244.56	12,812,169.17	13,120,893.12
归属于母公司股东的非经常性损益净额	421,159,723.76	622,416,824.47	91,109,608.36

法定代表人：

  


主管会计工作的负责人：

  


会计机构负责人：

  


**杭州士兰微电子股份有限公司**  
**最近三年非经常性损益明细表附注**

金额单位：人民币元

**一、重大非经常性损益项目说明**

(一) 非流动资产处置损益

1. 2022 年度非流动资产处置损益-3,122,546.18 元

项 目	金 额	说 明
固定资产处置收益	-486,573.36	公司处置固定资产形成的收益
处置长期股权投资产生的投资收益	142,579.41	公司出售杭州友旺科技有限公司股权产生的收益
固定资产报废损失	-2,778,552.23	公司报废无法使用的固定资产形成的损失
小 计	-3,122,546.18	

2. 2021 年度非流动资产处置损益-5,605,928.91 元

项 目	金 额	说 明
固定资产处置收益	146,119.31	公司处置固定资产形成的收益
固定资产报废损失	-5,752,048.22	公司报废无法使用的固定资产形成的损失
小 计	-5,605,928.91	

3. 2020 年度非流动资产处置损益-1,076,979.97 元

项 目	金 额	说 明
固定资产处置收益	2,193,770.15	公司处置固定资产形成的收益
处置长期股权投资产生的投资收益	456,517.58	公司出售浙江英达威芯电子有限公司股权产生的收益
固定资产报废损失	-3,727,267.70	公司报废无法使用的固定资产形成的损失
小 计	-1,076,979.97	

(二) 计入当期损益的政府补助

1. 2022 年度计入当期损益的政府补助 77,851,609.31 元

项 目	金 额	说 明
8 英寸项目补助	8,404,815.27	《关于拨付 2015 年市工业和信息化专项资金的通知》（杭财企〔2015〕178 号）、《关于下达 8 英寸集成电路芯片生产线项目资助资金的通知》（杭财企〔2016〕148 号）
2017 年集成电路重大项目中央基建投资资金	6,249,999.96	国家发展和改革委员会、工业和信息化部 2017 年集成电路重大项目补助资金
02 专项硅基 GaN 项目市级配套补助及三项目合并补助-区级配套补助	5,000,000.00	《关于下达 2021 年第三批杭州市科技发展专项资金的通知》（杭财教〔2021〕38 号）、《关于兑现钱塘区 2020 年-2021 年度国家科技项目配套政策奖励（补助）的通知》（钱塘经科〔2022〕15 号）
稳岗稳就补贴	4,317,961.04	《关于落实社会保险助企纾困有关政策的通知》（杭人社办发〔2022〕16 号）、《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（浙人社发〔2022〕37 号）、《关于做好 2020 年失业保险稳岗返还工作的通知》（杭人社发〔2020〕48 号）、《浙江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（浙人社发〔2021〕39 号）等
2021 年度杭州高新区(滨江)集成电路产业政策补助	3,579,020.00	《关于下达 2021 年度区集成电路产业政策资助资金的通知》（区经信〔2022〕24 号）
LED 驱动电源项目补助	3,000,000.00	《关于下达 2022 年第二批杭州市科技发展专项资金的通知》（杭财教〔2022〕17 号）
2020 年度工业头雁、工业雨燕、雏鹰政策奖励	2,674,000.00	《关于兑现 2020 年度钱塘区工业头雁、工业雨燕、雏鹰政策奖励（补助）的通知》
成都士兰项目基础设施补助	2,668,730.05	成都-阿坝工业集中发展区管理委员会《重大工业项目基础设施投资补充协议》
贷款贴息	2,628,100.00	《关于下达 2021 年州级工业发展专项资金（贷款贴息类）的通知》（阿州财建〔2022〕20 号）
高性能智能家电主控芯片研发产业化补助	2,468,200.00	《关于下达 2021 年第四批杭州市工业和信息化发展财政专项资金的通知》（杭财企〔2021〕64 号）
功率集成模块封装（PIM）技术开发及产业化	2,453,672.48	《关于下达 2014 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财〔2015〕20 号）；《关于下达 2015 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》（杭财企〔2015〕88 号）
进口贴息	2,300,298.00	《关于做好 2022 年中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》（浙商务联发〔2022〕41 号）
02 专项硅基 MEMS 项目地方配套补助	2,275,547.46	《关于下达 2021 年度国家 01-04 科技重大专项省市地方财政支持资金的通知》（杭财企〔2022〕54 号）
高清晰度实时视频监控 SOC 研发及应用补助	2,019,000.00	《关于下达 2020 年国家 01-04 科技重大专项浙江省地方财政支持资金的通知》（浙财建〔2021〕64 号）
2020 年企业研发费用政府补助	2,000,000.00	《关于兑现 2020 年度钱塘区企业研发投入政策奖励（补助）的通知》（钱塘经科〔2022〕18 号）
2021 年度领军培育企业资助	1,643,600.00	《关于给予杭州博日科技股份有限公司等 11 家企业 2021 年度领军教培资助的通知》（区发改〔2022〕82 号）
安全可控工业控制系统用系列 SoC 芯片研发和产业化	1,639,100.00	《核高基重大专项实施管理办公室关于 2017 年启动课题立项的批复》（工信专项一简〔2017〕118 号）、《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付核高基重大专项 2019 年中央财政经费的通知》（产发函〔2019〕311 号）
重点科研补助	1,461,200.00	《关于下达 2021 年第三批杭州市科技发展专项资金的通知》（杭财教〔2021〕38 号）、《关于兑现钱塘区 2020 年-2021 年度国家科技项目区配套政策奖励（补助）的通知》（钱塘经科〔2022〕15 号）
用于照明的蓝（白）光功率高压芯片的技术改造补助及 LED 封装技术改造补助	1,300,249.68	《关于下达 2017 年第二批杭州市工业与信息化发展财政专项资金的通知》（杭经开经〔2018〕58 号）
高压 IGBT 芯片工艺技术开发产业化	1,188,145.09	《关于下达 2013 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财〔2013〕501 号）；《关于下达 2014 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》（浙财企〔2014〕79 号）

项 目	金 额	说 明
外经贸进口贴息	1,144,310.00	《关于下达 2021 年外经贸专项资金进口贴息资金预算的通知》(成财产发(2021)55号)
鲲鹏计划市级奖励	1,017,000.00	《关于组织申报 2021 年度“鲲鹏计划”大企业集团上规模奖励的通知》
惯性传感器、地磁传感器和压力传感器的工艺及封装技术的研发并导入量产	915,621.77	《关于 02 专项 2013 年度项目立项批复的通知》(ZX02(2012)020号);《关于下达 2015 年国家 01-03 科技重大专项杭州市地方财政配套资金的通知》(杭财企(2015)152号);《关于下达 2015、2016 年国家 02 科技重大专项开发区财政配套资金的通知》(杭经开经(2017)175号)
厂房土建资助资金	909,973.44	《关于下达杭州士兰集成电路有限公司 8 英寸集成电路芯片生产线建设项目厂房土建部分资助资金的通知》(杭经开经(2018)219号)
四川省新经济示范企业奖	780,000.00	《关于下达 2021 年第二批省级工业发展专项资金的通知》(成财产发(2021)101号)
照明 LED 芯片技术改造项目	741,834.36	《关于下达 2019 年杭州市(第一批)集成电路产应发展专项资金的通知》(钱塘经科(2019)46号)
制造业奖励奖	740,000.00	《开展 2022 年一季度制造业企业奖励兑现工作的通知》
暖心八条送奖励	650,000.00	《关于钱塘区鼓励省外员工留区过年稳岗促产“暖心八条”第二条“开展送奖励”政策奖励企业名单的公示》
复合型智能传感器系统研发和产业化	520,000.00	杭州市滨江区财政局
一次性扩岗补贴	519,000.00	《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(人社厅发(2022)41号)
士兰功率集成电路省级重点企业研究院	512,300.00	《关于下达 2021 年中央引导地方科技发展资金的通知》(浙财科教(2021)18号)
中央外经贸发展专项资金	426,128.00	《关于下达 2022 年度中央外经贸发展专项资金的通知》(杭财企(2022)57号)
外经贸发展专项资金离岸服务外包项目的补贴	423,600.00	《关于下达 2022 年度中央外经贸发展专项资金的通知》(杭财企(2022)57号)
2021 年第三批国家专精特新“小巨人”奖励	400,000.00	《关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》(工信厅企业函(2021)79号)
新增年产 20 亿支高精密 LED 小间距封装生产线技术改造项目	394,378.92	《关于下达 2020 年第一批杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企(2020)33号)
知识产权补助	388,400.00	《关于申领 2022 年度省级知识产权专项资助经费的通知》
科技型研发补助	368,300.00	《关于兑现 2020 年度钱塘区企业研发投入政策奖励(补助)的通知》(钱塘经科(2022)18号)
外向型外贸资金补助	360,800.00	《关于下达 2022 年杭州市第三批外向型发展专项(外贸)项目资金及配套的通知区商务(2022)45号
硅基氮化镓(GaN)HEMT 结构电力电子芯片项目	360,703.46	《2020 年产业基础再造和制造业高质量发展专项》
数字诊疗装备研发试点专项补助	332,858.24	《关于国家重点研发计划数字诊疗装备研发试点专项 2020 年度项目立项的通知(一)》(国科生字(2020)27号)
数字化改造攻关项目补贴	322,320.24	《关于公布 2019 年杭州市制造业数字化改造攻关项目验收通过名单的通知》(杭经信产数(2019)108号)
2021 年商贸批发企业增量奖励	321,231.00	《关于组织申报 2021 年第三批商贸企业增量、存量奖励的通知》
建设汽车芯片测试和应用推广公共服务平台	320,900.00	《关于建设汽车芯片测试和应用推广公共服务平台项目向联合承研单位拨付合同经费的请示》
其他政府补助	5,710,310.85	
小 计	77,851,609.31	



2. 2021 年度计入当期损益的政府补助 62,614,254.22 元

项 目	金 额	说 明
8 英寸项目补助	8,404,815.24	《关于拨付 2015 年市工业和信息化专项资金的通知》（杭财企（2015）178 号）、《关于下达 8 英寸集成电路芯片生产线项目资助资金的通知》（杭财企（2016）148 号）
2017 年集成电路重大项目中央基建投资资金	6,249,999.96	国家发展和改革委员会、工业和信息化部 2017 年集成电路重大项目补助资金
高清晰度实时视频监控 SOC 研发及应用	4,375,700.00	《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付核高基重大专项事前立项事后补助课题后补助经费的通知》（产发函（2019）310 号）
士兰功率集成电路省级重点企业研究院资助资金	3,125,800.00	《关于下达 2021 年中央引导地方科技发展资金的通知》（浙财科教（2021）18 号）
区集成电路产业政策资助资金	3,000,000.00	《关于下达 2020 年度区集成电路产业政策资助资金的通知》（区经信（2021）28 号）
成都士兰项目基础设施补助	2,668,730.06	成都-阿坝工业集中发展区管理委员会《重大工业项目基础设施投资补充协议》
高性能智能家电主控芯片研发产业化资助资金	2,468,200.00	《关于下达 2021 年第四批杭州市工业和信息化发展财政专项资金的通知》（杭财企（2021）64 号）
科技研发补助	2,457,400.00	《关于进一步推进科技创新创业的若干政策》（钱塘管发（2019）30 号）
功率集成模块封装（PIM）技术开发及产业化	2,453,672.49	《关于下达 2014 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财（2015）20 号）；《关于下达 2015 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》（杭财企（2015）88 号）
安全可控工业控制系统用系列 SoC 芯片研发和产业化	2,420,000.00	《核高基重大专项实施管理办公室关于 2017 年启动课题立项的批复》（工信专项一简（2017）118 号）、《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付核高基重大专项 2019 年中央财政经费的通知》（产发函（2019）311 号）
工业互联网智能传感器、芯片研发及应用-MEMS 硅麦克风传感器的研发及其产业化	2,182,202.64	《关于提前下达 2019 年第一批省级科技发展专项资金的通知》（杭科计（2018）218 号、杭财教会（2018）245 号）
集成电路产业 BiCMOS 项目资助资金	1,308,800.00	《关于下达 2020 年第四批杭州市工业和信息化发展财政专项资金的通知》（杭财企（2020）70 号）
技术改造补助	1,300,249.73	《关于下达 2017 年第二批杭州市工业与信息化发展财政专项资金的通知》（杭经开经（2018）58 号）
高性能实时智能微控制器芯片研发及产业化资助资金	1,258,500.00	《关于下达 2020 年杭州市集成电路产业项目区级资助资金的通知》（区经信（2020）50 号）
软件产品增值税即征即退	1,233,345.07	《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税（2011）100 号）
高压 IGBT 芯片工艺技术开发产业化	1,188,145.10	《关于下达 2013 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财（2013）501 号）；《关于下达 2014 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》（浙财企（2014）79 号）
惯性传感器、地磁传感器和压力传感器的工艺及封装技术的研发并导入量产	1,187,532.70	《关于 02 专项 2013 年度项目立项批复的通知》（ZX02（2012）020 号）；《关于下达 2015 年国家 01-03 科技重大专项杭州市地方财政配套资金的通知》（杭财企（2015）152 号）；《关于下达 2015、2016 年国家 02 科技重大专项开发区财政配套资金的通知》（杭经开经（2017）175 号）
以工代训补贴	1,169,800.00	《关于印发企业职工培训实施细则的通知》（成人社办发（2020）59 号）
厂房土建资助资金	909,973.44	《关于下达杭州士兰集成电路有限公司 8 英寸集成电路芯片生产线建设项目厂房土建部分资助资金的通知》（杭经开经（2018）219 号）
稳岗就业补助	847,426.11	《关于转发人力资料社会保障部等五部门〈关于延续实施部分减负稳岗就业政策措施的通知〉》（川人社发（2021）14 号）、《浙

项 目	金 额	说 明
		江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（浙人社发〔2021〕39 号）
采购 MOCVD 设备补助	800,579.06	《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》（杭经开经〔2011〕543 号、杭经开财〔2011〕196 号、杭科计〔2011〕312 号）、杭经开经〔2014〕77 号、杭财教会〔2013〕67 号、杭经开经〔2014〕102 号）
高新技术补助	800,000.00	《关于下达 2020 年国家重点扶持领域高新技术企业补助计划的通知》（杭科高〔2020〕178 号）
照明 LED 芯片技术改造项目	741,834.34	《关于下达 2019 年杭州市（第一批）集成电路产应发展专项资金的通知》（钱塘经科〔2019〕46 号）
省级两化深度融合示范区项目资金	700,900.00	《关于下达杭州钱塘新区省级两化深度融合国家综合性示范区专项资金的通知》（钱塘经科〔2020〕143 号）
变频器用关键芯片、模块及检测能力建设项目	677,100.00	《关于发布 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金（部门预算）项目指南的通知》（工信部规函〔2017〕351 号）
专利资助经费	630,850.00	《关于下达杭州高新区（滨江）2019 年度区知识产权奖励资助经费的通知》（杭高新市监〔2021〕15 号）、《关于下达 2020 年杭州市第二批专利专项资金资助经费的通知》（杭市管〔2020〕173 号）、《关于印发〈杭州市专利专项资金管理办法〉的通知》（杭市管〔2019〕165 号）、《关于转拨 2018-2019 年杭州市专利专项资金资助经费的通知》（杭市管〔2019〕186 号）、《关于申领省、市发明专利资助的通知》
省级循环化改造示范试点园区专项资金	600,000.00	《关于下达杭州经济技术开发区省级循环化改造示范试点园区重点项目专项资金》（钱塘经科〔2020〕136 号）
商业发展增长支持	500,000.00	《关于印发深圳市福田区产业发展专项资金系列政策的通知》（福府办规〔2020〕5 号）
数字诊疗装备研发试点专项补助	497,975.09	《关于国家重点研发计划数字诊疗装备研发试点专项 2020 年度项目立项的通知（一）》（国科生字〔2020〕27 号）
2019 年中央外经贸发展专项资金（进口贴息）	409,395.00	《关于申报 2020 年进口贴息有关事项的通知》（川商外贸〔2020〕15 号）
新增年产 20 亿支高精密 LED 小间距封装生产线技术改造项目	394,378.92	《关于下达 2020 年第一批杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（杭财企〔2020〕33 号）
数字化改造攻关项目补贴	322,320.25	《关于公布 2019 年杭州市制造业数字化改造攻关项目验收通过名单的通知》（杭经信产数〔2019〕108 号）
其他零星补助	5,328,629.02	
小 计	62,614,254.22	

### 3. 2020 年度计入当期损益的政府补助 116,936,036.71 元

项 目	金 额	说 明
02 专项硅基 GaN 项目补助	14,945,200.00	“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室《关于“硅基 GaN 器件与集成电路工艺融合技术研究”课题增加联合承担单位的通知》
惯性传感器、地磁传感器和压力传感器的工艺及封装技术的研发并导入量产	12,743,724.43	《关于 02 专项 2013 年度项目立项批复的通知》（ZX02〔2012〕020 号）；《关于下达 2015 年国家 01-03 科技重大专项杭州市地方财政配套资金的通知》（杭财企〔2015〕152 号）；《关于下达 2015、2016 年国家 02 科技重大专项开发区财政配套资金的通知》（杭经开经〔2017〕175 号）
社保返还、失业金退款	10,450,553.65	《关于做好 2020 年失业保险稳岗返还工作的通知》（杭人社发〔2020〕48 号）、《杭州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（杭政函〔2019〕19 号）、《关于做好暂时困难企业稳岗补贴审定工作的补充通知》（成人社发〔2019〕29 号）、《关于进一步做好技术技能提升补贴有关工作

项 目	金 额	说 明
		的通知》（成人社发〔2019〕29号）
采购 MOCVD 设备补助	8,813,682.24	《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》（杭经开经〔2011〕543 号、杭经开财〔2011〕196 号、杭科计〔2011〕312 号）、杭经开经〔2014〕77 号、杭财教会〔2013〕67 号、杭经开经〔2014〕102 号）
8 英寸项目补助	8,404,815.24	《关于拨付 2015 年市工业和信息化专项资金的通知》（杭财企〔2015〕178 号）、《关于下达 8 英寸集成电路芯片生产线项目资助资金的通知》（杭财企〔2016〕148 号）
传感器结构及芯片设计、传感器信号处理电路、传感器批量测试技术研究	6,530,000.00	《关于 02 专项 2013 年度项目立项批复的通知》（ZX02〔2012〕020 号）
2017 年集成电路重大项目中央基建投资资金	6,196,274.34	国家发展和改革委员会、工业和信息化部 2017 年集成电路重大项目补助资金
厂房土建资助资金	3,659,973.39	《关于下达杭州士兰集成电路有限公司 8 英寸集成电路芯片生产线建设项目厂房土建部分资助资金的通知》（杭经开经〔2018〕219 号）
高清晰度实时视频监控 SOC 研发及应用	2,936,300.00	《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付核高基重大专项事前立项事后补助课题后补助经费的通知》（产发函〔2019〕310 号）
高性能手机快速充电芯片解决方案研发及产业化	2,712,400.00	《关于公布 2019 年（第二批）杭州市集成电路产业发展专项项目名单的通知》（杭经信电子〔2019〕113 号）
成都士兰项目基础设施补助	2,668,730.08	成都-阿坝工业集中发展区管理委员会《重大工业项目基础设施投资补充协议》
技能提升补贴	2,535,841.00	《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（杭人社发〔2020〕94 号）、《金唐县 2020 年困难企业职工培训补贴情况公示》
高压模块芯片制造和功率模块组件封装	2,515,893.90	《关于下达 2015 年国家 01-03 科技重大专项浙江省地方财政配套资金的通知》（杭财企〔2015〕82 号）、《关于下达 2015 年国家 01-03 科技重大专项杭州市地方财政配套资金的通知》（杭财企〔2015〕152 号）
功率集成模块封装（PIM）技术开发及产业化	2,453,672.49	《关于下达 2014 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财〔2015〕20 号）；《关于下达 2015 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》（杭财企〔2015〕88 号）
工业企业结构调整专项奖补资金	2,437,790.00	《关于印发“工业企业结构调整专项奖补资金管理办法”的通知》（财建〔2016〕253 号）
安全可控工业控制系统用系列 SoC 芯片研发和产业化	1,656,000.00	《核高基重大专项实施管理办公室关于 2017 年启动课题立项的批复》（工信专项一简〔2017〕118 号）、《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付核高基重大专项 2019 年中央财政经费的通知》（产发函〔2019〕311 号）
知识产权专项资金	1,509,150.00	《关于进步加强知识产权工作的实施意见》（杭高新〔2017〕66 号）、《浙江省财政厅关于提前下达 2020 年市场监管和知识产权专项资金的通知》（浙财行〔2019〕51 号）
低功耗高性能音频处理系列芯片的研发及产业化	1,434,000.00	《关于下达 2019 年杭州市工信产业发展专项项目区配套资金的通知》（区经信〔2020〕3 号）
2019 年省级工业发展资金	1,330,000.00	《关于组织开展 2019 年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2018〕244 号）
技术改造补助	1,300,249.65	《关于下达 2017 年第二批杭州市工业与信息化发展财政专项资金的通知》（杭经开经〔2018〕58 号）
中央外经贸发展专项资金	1,283,277.00	《关于做好 2020 年中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》（浙商务联发〔2020〕23 号）
2019 年中央外经贸发展专项资金（进口贴息）	1,268,330.00	《关于做好 2019 年中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》（浙商务联发〔2019〕17 号）、《关于 2019 年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》（财行〔2019〕137 号）

项 目	金 额	说 明
高性能实时智能微控制器芯片研发及产业化	1,258,500.00	《关于下达 2020 年第四批杭州市工业和信息化发展财政专项资金的通知》（杭财企〔2020〕70 号）
2019 年集成电路产业发展专项资金	1,245,700.00	《关于下达 2019 年杭州市（第一批）集成电路产业发展专项资金的通知》（钱塘经科〔2019〕46 号）、《关于公布 2019 年（第二批）杭州市集成电路产业发展专项项目名单的通知》（杭经信电子〔2019〕113 号）
高压 IGBT 芯片工艺技术开发产业化	1,188,145.09	《关于下达 2013 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财〔2013〕501 号）；《关于下达 2014 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》（浙财企〔2014〕79 号）
“鲲鹏计划”大企业上规模奖励	1,000,000.00	《关于组织申报 2019 年度“鲲鹏计划”大企业大集团上规模奖励的通知》（杭经信运行〔2020〕98 号）
复合型智能传感器系统研发和产业化	949,000.00	杭州市滨江区财政局
照明 LED 芯片技术改造项目	741,834.34	《关于下达 2019 年杭州市（第一批）集成电路产业发展专项资金的通知》（钱塘经科〔2019〕46 号）
变频器用关键芯片、模块及检测能力建设项目	712,900.00	《关于发布 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金（部门预算）项目指南的通知》（工信部规函〔2017〕351 号）
2019 年第二批省级科技发展专项资金	600,000.00	《关于下达 2019 年第二批省级科技发展专项资金的通知》（杭科计〔2019〕35 号、杭财教会〔2019〕16 号）
高频 BICMOS 集成电路制造工艺研发和产业化	529,852.89	《关于下达 2012 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财〔2012〕610 号）
浙江省科技进步奖一等奖	500,000.00	《关于下达 2019 年度国家科学技术奖获奖奖励资助的通知》（区科技〔2020〕15 号）
2019 年度人才激励专项资金资助	468,449.00	《关于下达 2019 年度第一批人才激励专项资金的通知》（区财政〔2020〕39 号）
工业互联网智能传感器、芯片研发及应用-MEMS 硅麦克风传感器的研发及其产业化	381,730.47	《关于提前下达 2019 年第一批省级科技发展专项资金的通知》（杭科计〔2018〕218 号、杭财教会〔2018〕245 号）
2019 年杭州市工信产业发展专项项目区配套资金	319,600.00	《关于下达 2019 年第二批杭州市工信产业发展专项项目区配套资金的通知》（区经信〔2020〕6 号）
其他零星补助	7,254,467.51	
小 计	116,936,036.71	

### （三）委托他人投资或管理资产的损益

2022 年度、2021 年度和 2020 年度分别为 460,202.12 元、68,672.85 元和 114,799.12 元，均系公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品取得的收益。

（四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

2022 年度、2021 年度和 2020 年度分别为 426,383,780.71 元、686,107,163.58 元和 4,062,459.89 元，其中权益工具投资确认的公允价值变动分别为 431,592,785.19 元、685,639,996.32 元和 3,263,325.73 元；远期结售汇产生的损益分别为-5,209,004.48 元、467,167.26 元和 1,108,270.38 元；2020 年度黄金交易及掉期业务产生的损益为-309,136.22

元。

(五) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1. 2022 年度 1,491,083.84 元, 主要系无需支付的款项收入 1,160,314.36 元, 赔款收入 986,221.99 元, 赔款支出 764,982.52 元, 除此之外的其他营业外收入和支出 109,530.01 元;

2. 2021 年度 1,739,378.52 元, 主要系赔款收入 2,486,844.97 元, 罚没收入 505,468.07 元, 无法收回的款项支出 1,012,313.72 元, 赔款支出 654,654.30 元, 除此之外的其他营业外收入和支出 414,033.50 元;

3. 2020 年度 1,777,112.19 元, 主要系罚没收入 561,224.63 元, 赔款收入 589,627.03 元, 无需支付的款项收入 541,770.93 元, 赔款支出 399,050.09 元, 除此之外的其他营业外收入和支出 483,539.69 元。

**二、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明**

2022 年度 1,369,132.67 元, 系代扣代缴个税手续费返还 737,107.63 元等; 2021 年度 -1,306,883.83 元系股份支付费用-1,925,567.13 元和代扣代缴个税手续费返还 618,683.30 元; 2020 年度 788,598.90 元系代扣代缴个税手续费返还。

**三、根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明**

无根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

